

# 樹脂コア金属被覆微粒子

## マイクロパールAUシリーズ



GAP保持



導通・導電

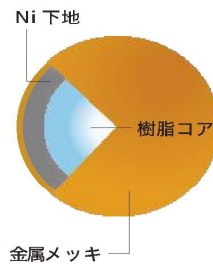


製品HP / お問い合わせ

### 特徴

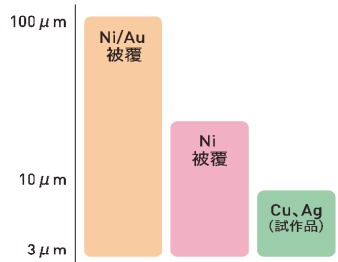


#### ■ 構成例



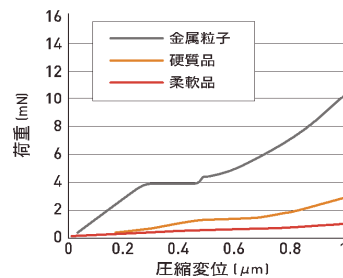
- 1 均一な粒径分布のプラスチック粒子に均一な金属層を形成
- 2 様々な金属層の形成が可能  
Au、Ni、Cu、Agなど
- 3 独自のポリマー設計技術により、粒子硬さ・反発力の制御が可能
- 4 金属粒子より柔軟

#### 粒子ラインナップ



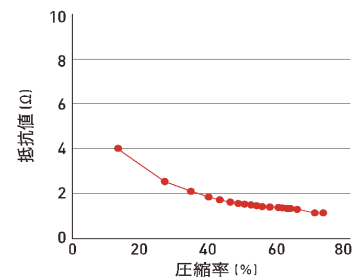
豊富な粒子径、金属種をラインナップしています。

#### 硬さ評価データ



3 μm Ni/Au 被覆粒子データ  
金属粒子より柔軟な特性を有しています。

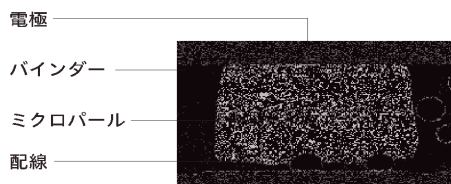
#### 抵抗値評価データ



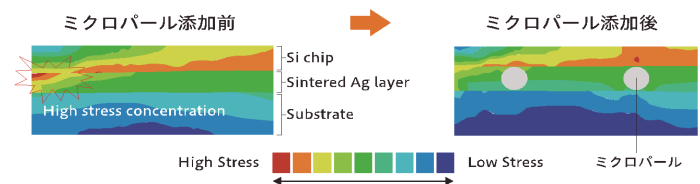
3 μm Ni/Au 被覆柔軟品データ  
柔軟な特性により圧縮変形し抵抗値低減します。

### 用途例

#### 導通接続用途

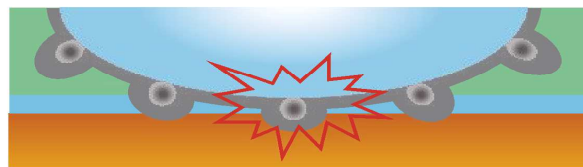


#### 応力緩和用途



#### 突起形成技術

突起が表面酸化膜を破り低抵抗化

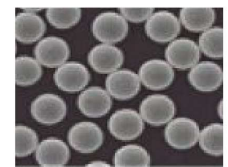


突起部の拡大図



#### 単分散技術

金属被覆後も単分散



積水化学工業株式会社 高機能プラスチックカンパニー エレクトロニクス戦略室  
<https://www.sekisui.co.jp/electronics/>